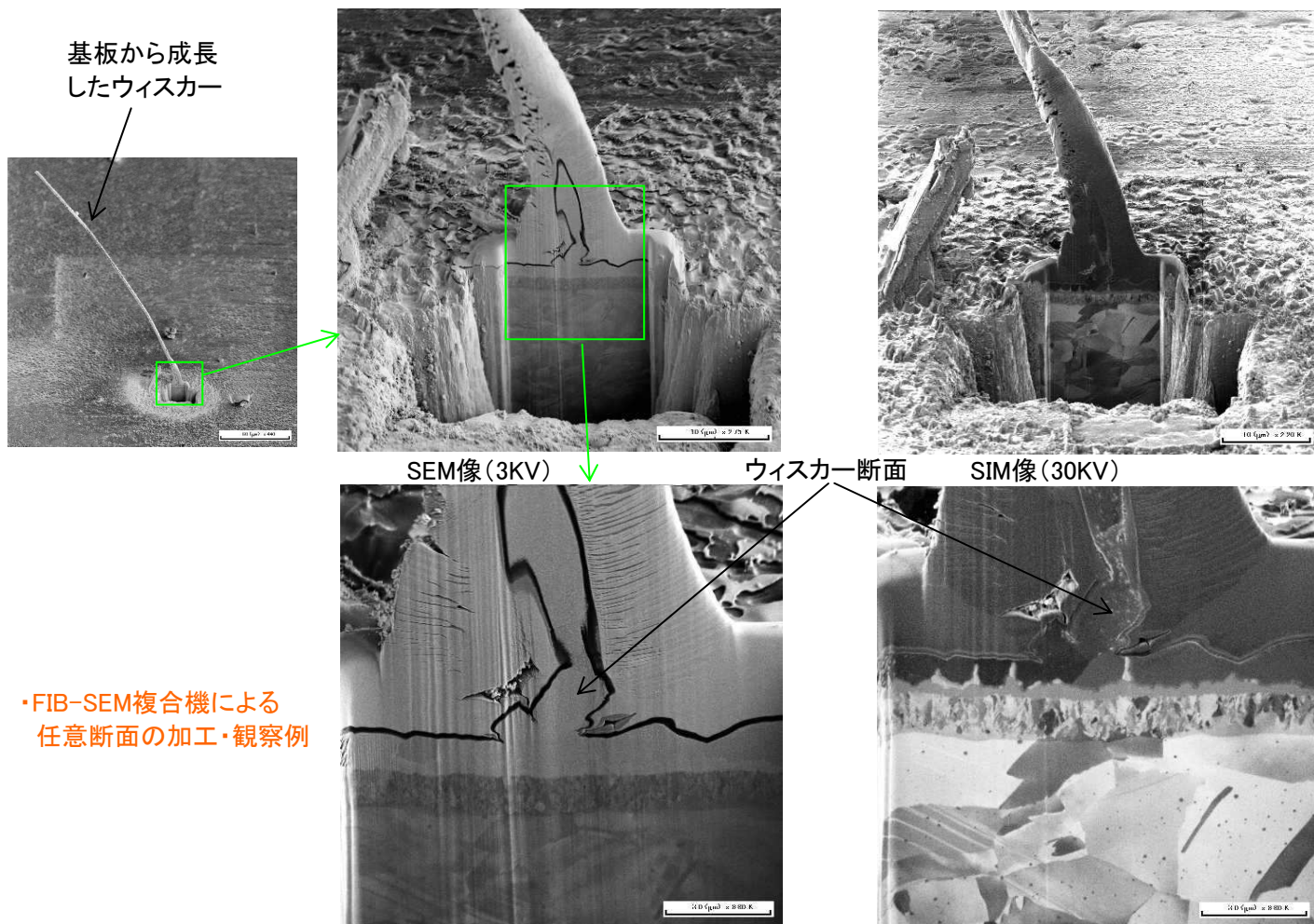




## 【1】FIBによる断面構造観察 FIB:集束イオンビーム装置

☆ウイスカー断面をFIB加工し、側面方向からのSEM観察およびSIM観察で、マクロな構造解析が可能です。



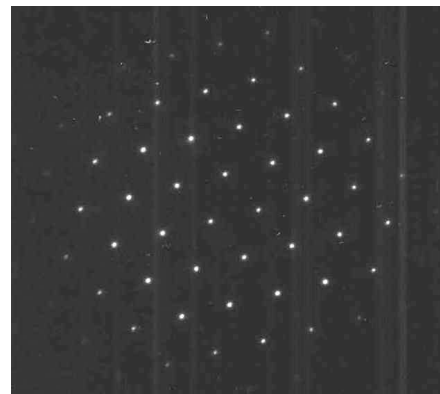
## 【2】TEM構造解析による微細構造観察と組成分析 TEM:透過型電子顕微鏡

☆FIBによるTEM試料作製とTEM/STEM観察で、ミクロな微細構造が観察できます。  
 ☆組成(EDS/EELS)分析では、nmサイズの微小部位における組成分析が可能です。

EDS:エネルギー分散型スペクトルスコープ  
 EELS:電子線エネルギーロススペクトルスコープ

## 【3】電子線回折による化学結合の同定

☆TEM試料を使ったTEM電子線回折法で、微小部位の化学結合が同定できます。



・AuIn<sub>2</sub>と同定した例

## 【4】ウイスカーの電気抵抗測定

☆ナノプローバ(SEMチャンバー内に組み込まれたプローバ)で、 $\mu\text{m}$ サイズのウイスカーの電気抵抗が四端子法で測定できます。